

)
 .2. -
 (, -)

, -
 12 18 9 ~ 5 -
 ~ 4 .

: 1. . . , . . .
 // . 2, 2006. .

27-32. 2. A.I.II insky, S.I.Lyabuk, A.I.Zubkov. Relaxation resistance of copper films strengthened with molybdenum nanoparticles.// Functional Materials.-2003.-10.- 1.-P.52-54.

. 621.771.22.001.5.

_____ . „ . . .

1000/850/630 -130
 203 , -250 260 .

-

,

.
.
.

5, 6, 7

-

-

.

-

,

1:4

.

330.

30

4543-71,

-

32

-

.

300

1050⁰

-

10-15⁰

1/3

. 1.

,

-

.

: 1.

. .,

. . . «

» .:

1970.- .-

358. 2.

. .,

. .,

. . . «

» .:

-

1971.- .- 512

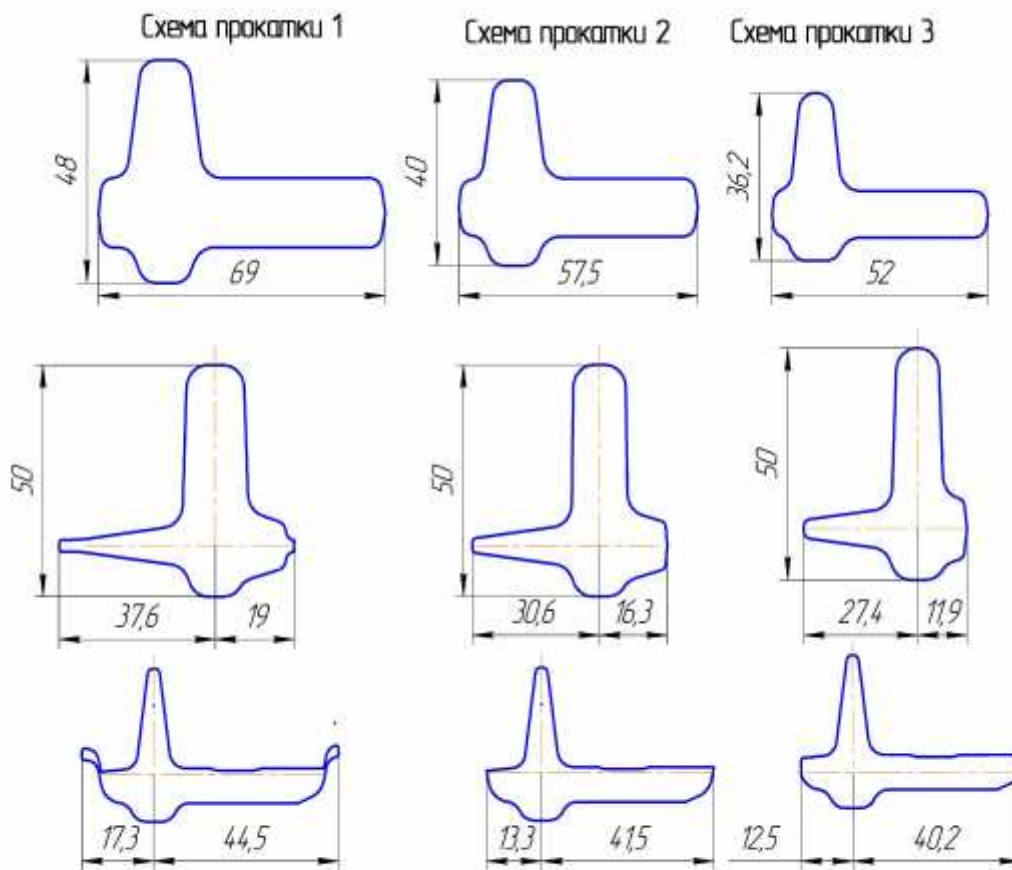


Рис. 1 Обводки темплетов по трем схемам прокатки

621.771.26.011